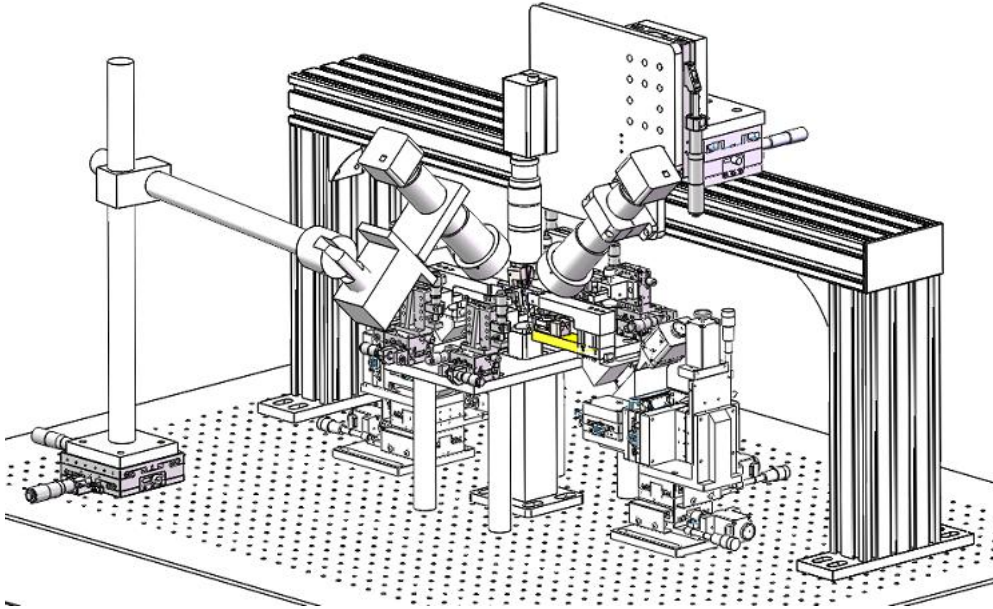


CA-1000硅光芯片自动耦合系统



产品描述

CA-1000是一款硅光芯片自动耦合系统，通过图像识别实现关键步骤的自动化，通过高精度移动平台、隔振系统、亚微米级人工智能算法识别旋转中心，从而提高测试精确度和效率。

产品特点

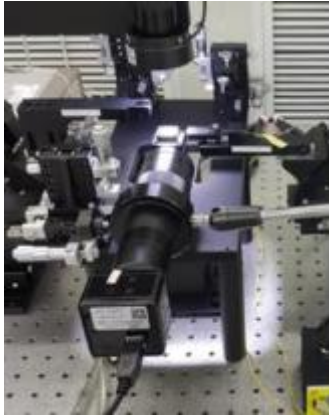
- 光功率耦合精度误差： $<0.1\text{dB}$
- Sensor防撞设计（可选），精度 $2\sim 3\mu\text{m}$
- 支持定制化开发服务
- 通过更换平台可实现快速耦光
- 可兼容其他类型芯片测试

产品应用

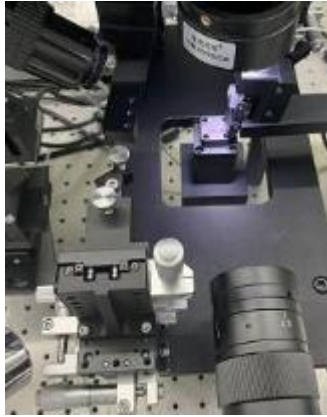
该系统可兼容多种类型芯片、Bar条测试，包含无源芯片和有源芯片等。配合仪表可测试IL、ER、RL、FSR、响应度等芯片相关性能指标，通过机器视觉算法可实现自动对光、自动压接探针卡等，中间过程无需人工参与。

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。





FA Test for Edege Coupler



FA Test for Grating Coupler



Electric Test

轴	X, Y, Z	$\theta X, \theta Y, \theta Z$	单位
行程	$\geq 30\text{mm}$	$\geq 8^\circ$	-
分辨率	$\leq 50\text{nm}$	$\leq 0.003^\circ$	-
重复精度	$\leq 1\mu\text{m}$	$\leq 0.02^\circ$	-
最小芯片模斑 ¹	1.5		μm
耦合重复性	<0.2		dB
耦合时间	<10		s
光功率耦合精度误差	<0.1		dB
耦合方式	Grating Coupler、Edge Coupler		-
响应模式	光反馈（功率计）、电反馈（源表）		-

备注：

1. 如有特殊需要，请通过更换移动平台可支持更小模斑测试。

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

